

СОДЕРЖАНИЕ

Фундаментальные исследования

<i>Малышев И.В., Филь К.А., Гончарова О.А.</i> Определение компонент объемной проводимости полупроводников типа $A^{III}B^V$ в сильных постоянных электрических полях и при гармоническом воздействии	7
---	---

Материалы электроники

<i>Белогорохов И.А., Белогорохова Л.И.</i> Исследование композиционных материалов на основе полистирола и сахарозы методом ИК-спектроскопии	16
---	----

Технологические процессы и маршруты

<i>Белов А.Н., Голишников А.А., Костюков Д.А., Шевяков В.И.</i> Металлизация высокотемпературных кремниевых ИС на основе сплава вольфрама с титаном	22
<i>Евдокимова Н.Л., Долгов В.В., Иванов К.А.</i> Определение теплового сопротивления кристалл – корпус полупроводникового прибора из его кривой охлаждения	30

Элементы интегральной электроники

<i>Гуминов Н.В., Мьё Мин Тхант, Романюк В.А., Шомахмадов Д.П.</i> Сравнение характеристик GaAs и GaN HEMT-транзисторов	42
--	----

Информационно-коммуникационные технологии

<i>Матюшкин И.В., Заплетина М.А.</i> Отражение и транспонирование данных в матрице клеточно-автоматного вычислителя	51
<i>Минаков Е.И., Валтин Г.А.</i> Определение потерь распространения радиолокационной волны вблизи земной поверхности	64
<i>Ермошенко Ю.М.</i> Модель вектора состояния в виде квазислучайного процесса для комплексного аэрологического радиозондирования атмосферы	72
<i>Виноградов А.Н.</i> Модель системы управления движением мобильного робота на основе нечеткой логики	79

Краткие сообщения

<i>Ключников А.С., Красюков А.Ю., Артамонова Е.А., Королёв М.А., Ефимова Д.И.</i> Влияние толщины пленки кремния КНИ-структуры на параметры планарного беспереходного МОП-транзистора	87
<i>Сергеев В.А., Фролов И.В., Радаев О.А.</i> Связь уровня фототока светоизлучающих InGaN/GaN-гетероструктур с уровнем НЧ-шума и порогового тока	92

Открытие Центра компетенций национальной технологической инициативы «Сенсорика» в МИЭТ	97
--	----

Объединенная выставка ЭлектронТехЭкспо и ЭкспоЭлектроника	3 стр. обложки
26-я Всероссийская межвузовская научно-техническая конференция студентов и аспирантов «Микроэлектроника и информатика - 2019»	4 стр. обложки